

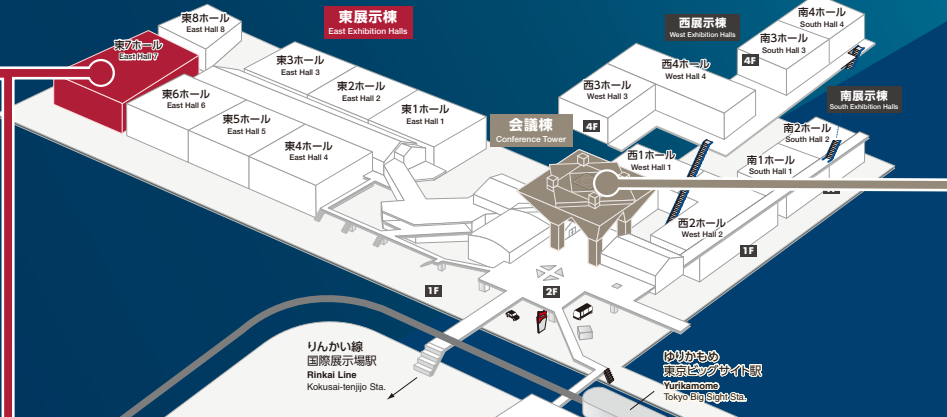


# カンファレンスプログラム

## CONFERENCE VENUE OVERVIEW

# 1月23日 [木]

Jan.23 [Thu.]



### カンファレンス会場A CONFERENCE VENUE A

**AUTO-EV3** 10:00-11:30  
2027年のxEVに求められる電気駆動システム(e-Axle)の技術潮流とそのシステムインパクト  
Technical Trend and System Impact of Electric Drive Power Train (e-Axis) for xEV in 2027  
名古屋大学 未来材料システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真樹  
Toyota Motor, Future Material System Research Center, Future Electron Library, Nagoya Institute of Technology

**AUTO-EV51** 12:30-13:40  
マルチバスケイ戦略の鍵となる技術  
Key Technologies for "Multi-buskey" Approach  
トヨタ自動車(株) パワートレインカンパニー フレグメント 上原 隆史  
Toyota Motor, Power Train Division, Vehicle System Development Center, Power Train System Development Dept.

**PDM-S2** 15:00-16:10  
パワーデバイス サミット ~パワーデバイスの現状と展望を徹底討論~  
Power Device Summit: Panel Discussions on the Current Situation and Future Outlook of Power Devices  
インフオニクステクノロジーズ ジャパン(株) インドストリアル&インフラストラクチャー 事業本部 事業本部長 加藤 毅  
Infonix Technology Japan, Industrial & Infrastructure Business Dept., Business Manager, Tetsuya Kato

### カンファレンス会場B CONFERENCE VENUE B

**NEPCON-S3** 10:00-11:10  
AIは産業をいかに変革するか ~要素技術から未来の姿まで徹底解説~  
How AI is Transforming Industries - Explanation from Underlying Technologies to Future Prospects  
富士通(株) 富士通研究所 人工知能研究所 所長 園田 俊浩  
Fujitsu, Fujitsu Research Institute, AI Research Institute, Institute Director, Shunho Sonoda

**WEA-S1** 12:30-13:40  
次世代ウェアラブルの誕生秘話! デバイス開発の最前線を追う  
Frontiers of Wearable Device Development: The Inside Story of Next-Generation Wearables  
サンテックグローバルイノベーションセンター(株) 社長 村上隆典 水谷 治典  
Santec Global Innovation Center, President, Takayuki Murakami, Shigeaki Mizutani

### 注意事項 Caution

**<注意事項>**

- カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
  - ① 展示会場入場に必要な出場者パスワ①
  - ② カンファレンス受講に必要な受講券②
- 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

**<Caution>**

- Visitor Badge for entering exhibition. \*Please register beforehand. A confirmation e-mail with other badge will be sent to the e-mail you registered. Download and print out with the online badge is advised and bring it with you to the exhibition.
- Conference Ticket. \*We email with conference ticket attached will be sent to your e-mail. Show the conference ticket (printed or show it on phone) at the reception of conference venue.

Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.  
●Recording and photography are strictly prohibited.  
●Speakers and programs are subject to change.  
●Textbooks of keynote/special sessions are not available.

マイページはこちら  
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込はこちら  
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

## 会議棟 CONFERENCE TOWER

**7F 国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL**

**ISP-3** 10:00-11:30  
次世代半導体パッケージにおける最先端実装技術動向  
Leading Trends in Emerging Technology for Next-Generation Semiconductor Packaging  
(株)レニテック エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター センター長 轟山 龍一  
Lenitech, Electronic Business Dept., Packaging Solution Center, Center Director, Ryuuichi Hoshikawa

**AUTO-SDV4** 12:30-14:00  
SDVの次世代技術ロードマップと統合ECU開発  
Next-gen. Technology Roadmap for SDV and Integrated ECU Development  
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター ソフトウェア開発 チーフソフトウェアリーダー 今井 孝志  
Toyota Motor, Digital Software Development Center, Software Development, Chief Software Leader, Takashi Imai

**AUTO-ONS1** 15:00-16:10  
自動車の資源循環モデルの確立と最新技術開発  
Establishment and Latest Cutting-edge Technologies for Circular Economy in Automobiles  
道徳者 瑞穂啓生・経済情報部 総経理 資源循環ビジネス推進室 資源循環ビジネス推進室長 河田 隆平  
Michizuka, Ryohei, Ethics & Environmental Information Dept., Chief Executive Officer, Resource Circulation Business Promotion Room, Resource Circulation Business Promotion Room Manager, Takahiro Kawada

**AUTO-CN3** 10:00-11:30  
車体のカーボンニュートラルに向けた新技術  
New Technology to Achieve Carbon Neutrality in Vehicle Body Production  
東京建設(株) グリーンEV新車事業推進 プロジェクト上級マネージャー 中西 栄二朗  
Tokyo Koseki, Green EV New Vehicle Business Promotion, Project Senior Manager, Eiji Nakanishi

**SLE-S1** 13:00-13:40  
サステナブルなロジスティクス構築を目指す ~オルビス流DX推進の取組み~  
Aiming to Build Sustainable Logistics with Style (Orbis Flow DX Promotion Initiatives)  
オウルズ(株) SCM部 ロジスティクス推進グループマネージャー 柳田 和宏  
Owls, SCM Dept. Logistics Promotion Group Manager, Kazuhiro Yanagida

**SLE-S2** 15:00-16:30  
M&Aは人手不足の運輸業を救うのか? 成功事例から学ぶ  
Can M&A Solve the Labor Shortage in the Transportation Industry? Lessons From Successful Cases  
フジノホールディングス(株) マーケティング部長 執行役員 川上 義生  
Fujino Holdings, Marketing Dept. Manager, Executive Director, Yoshiaki Kawasaki

**PWB-3** 10:00-11:30  
実用化が見えてきたガラスサブストレートの必要性、課題、世界動向について語る  
Glass Substrates are beginning to be Put to Practical Use. Talk About Needs, Challenges and Global Trends  
エスエス(株) 電子・材料・生産技術開発部 総務・実行技術開発課 長 吉川 眞一  
SSC, Electronics/Materials/Manufacturing Engineering, Dept. Sec'y, Execution Technology Development, Gen. Manager, Makoto Yoshikawa

**ISP-4** 15:00-16:30  
圧倒的な低消費電力化で 半導体プレイヤーを変える光電融合技術  
Optoelectronics - Ultra-low Power Consumption is a Game Changer for Semiconductors-  
(国) 産業技術総合研究所 プラットフォームテクノロジクス研究センター 研究センター長 鈴木 周  
NISTEP, Platform Technology Research Center, Center Director, Shuuji Suzuki

**AUTO-MS2** 10:00-11:10  
世界のMaas事例 ~中国のロボタクシーや無人運転サービス社会を学ぶ~  
(Case Studies) Overseas Maas -Robotaxis in China and Driverless Mobility Service-  
(株)現代文化研究所 調査・研究本部 総経理/リーダー 上原 佳洋 八杉 理  
Modern Culture Research Institute, Research Dept. Chief Executive/Leader, Yoshihiro Uehara, Ritshi Yashiki

**FIW-S4** 12:30-13:40  
中小企業のGXどう進める? 政府の取り組みと事例を紹介  
How to Advance GX for SMEs? Government Initiatives and Case Study  
経済産業省 GXチーム GX推進企画部長 萩野 淳平  
Ministry of Economy, Trade and Industry, GX Team, GX Promotion Planning, Chief, Junpei Hagiwara

**FIW-S5** 15:00-15:40  
バーチャルファクトリーの価値を考える  
Considering the Value of Virtual Factories  
日工機工(株) 代表取締役 セールズグループ マネージャー 三橋 修  
Nissei Koki, Representative Director, Sales Group Manager, Tamiaki Mihashi

**FIW-S3** 10:00-10:40  
社会実装における ヒューマノイドロボットの無限の可能性  
Infinite Possibilities of Humanoid Robots in Social Implementation  
Boston Dynamics Inc., Chief Strategy Officer, marc theermann

**NEPCON-K** 12:30-13:40  
半導体における最新技術戦略と展望とは  
Latest Technology Strategy and Future Outlook in Semiconductor  
(株)SK hynix inc. HBM Design Dept., Director, Hyunwoo Kim  
SK hynix inc., HBM Design Dept., Director, Hyunwoo Kim

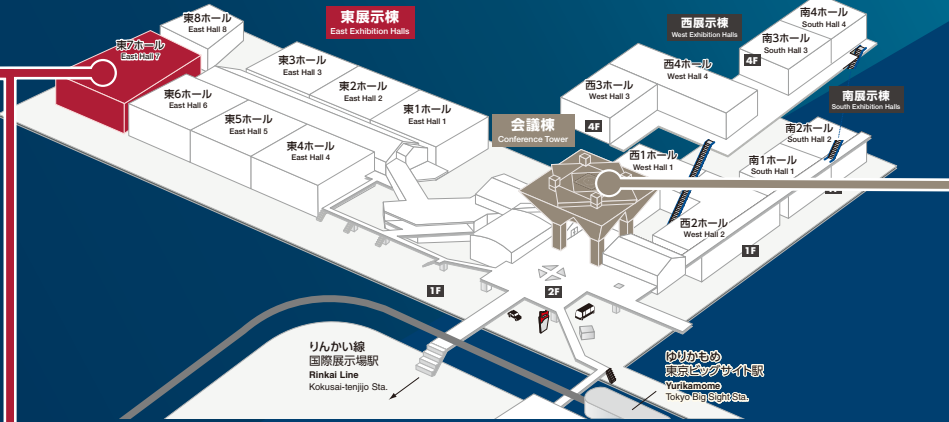
**PWB-4** 15:00-16:30  
次世代パッケージ基板技術の最前線  
Cutting-edge Technologies in Next-generation Package Substrates  
(国) 産業技術総合研究所 主任研究員 藤本 謙博  
NISTEP, Chief Researcher, Kenhiro Fujimoto

# カンファレンスプログラム

## CONFERENCE VENUE OVERVIEW

# 1月24日 [金]

Jan.24[Fri.]



### カンファレンス会場A CONFERENCE VENUE A

**NEPCON-S4** 10:00-11:10  
はんだ最新線！国際規格と先端技術の最新動向  
The Frontline of Soldering: Latest Trends in International Standards and Advanced Technologies

(株)東海理化 生産開発部 総合生産室 室長 鈴木 貞人  
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長 西森 久雄

**AUTO-SDVS2** 12:30-13:40  
ソフトウェアファーストが生み出す新たなモビリティの価値  
The New Value of Mobility Created by Software-first

(株)NTTデータ 取締役社長執行役員 有馬 勲  
(株)デンソー 上席執行役員 モビリティエレクトロニクスグループ長 近藤 浩

**PDM-S3** 15:00-16:10  
カーボンニュートラルを実現するパワーデバイス技術とは  
Power Devices which Help to Achieve Carbon Neutrality

(株)安川電機 執行役員 インバータ事業部長 兼 インバータ技術部長 博士(工学) 井手 耕三  
(株)TMEIC 執行役員 パワーエレクトロニクスシステム事業部 事業部長 飛田 正孝

### カンファレンス会場B CONFERENCE VENUE B

**WEA-S2** 10:00-11:10  
進化する建設現場！ウェアラブル導入で生まれた建設現場革新の実例と成果  
Case Study: Innovations in Construction Sites Driven by Wearable Devices

(株)竹中工務店 広島支店 生産総務部 プロダクトグループマネージャーフェーズパートナー 二宮 義典  
オリンクス(株) 事業部第二部 第一チーム 佐藤 加奈子  
セーフィー(株) 事業本部第2ビジネスユニット 部長 渡部 郁巳

**AUTO-CN4** 12:30-14:00  
サーキュラーエコノミーを実現する自動車のアルミニウムサイクル技術  
Recycling Technologies of Automotive Aluminum Parts for Circular Economy

(株)UACJ マーケティング/技術本部 R&Dセンターリーダー 見島 洋一  
日産自動車(株) 企画・先行技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ主管 瀧島 文彦

**AUTO-SDVS5** 15:00-15:50  
SDV実現に向けた開発効率化へのアプローチとは？  
Increasing Development Efficiency to Realize SDVs

ボッシュ(株) ボッシュモビリティ 東アジア-東南アジア 技術統括部門 技術統括-エンジニアリング統括 森田 泰弘

### 注意事項 Caution

- 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

\*1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者パス」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。  
\*2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより要領書ダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Textbooks of Keyword/Special Sessions are not available.

マイページはこちら  
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込はこちら  
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

### 会議棟 CONFERENCE TOWER

国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

**ISP-5** 10:00-11:30  
クルマの未来を切り開く最新半導体テクノロジー  
The Latest Semiconductor Technology to Open Up the Future of Cars

オートモティブ プロダクト マーケティング シニアディレクター 森下 和彦  
(株)デンソー エレクトロニクス事業部 ASIC技術担当 部長 松本 隆

**PWB-6** 12:30-14:00  
6Gに向けた次世代高速通信向けの開発・技術動向  
Next-generation high-speed application development and technology trend for 6G

(株)リネックス エレクトロニクス事業本部 開発センター 開発材料開発部 チームリーダー 日暮 直哉  
(株)S&Rテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦

606

**FIW-S6** 10:00-11:10  
見える化でカーボンニュートラル！スコープ3を見据えた取り組み  
Carbon Neutral Manufacturing by Visualization, with Scope 3 in Mind

アスエネ(株) Co-Founder 取締役 COO 岩田 直弘  
(株)NTTデータ コンサルティング事業本部 サステナビリティ/カーボンニュートラル推進室 室長 南田 雅博

**AUTO-EV4** 12:30-14:00  
次世代モータ開発～環境、調達リスクの2大課題解決へ～  
Next-Gen. Motor Development - To Overcome Environmental & Procurement Risks

(株)プロテリオン 磁気材料事業部 室長 西内 武典  
(株)ヴァレオジャパン パワーデバイス/エンジン/トランスミッション部 室長 宮川 廉

**SLE-S3** 15:00-16:10  
サステナブルでグリーンな物流を実現！先進的な取り組みから学ぶ  
To Achieve Sustainable Logistics: Learn From Latest Case Studies

Sustainable Shared Transport(株) 代表取締役社長 / ヤマト運輸(株) グリーン物流事業部長 高野 茂孝  
Dignitas (株) President and COO, General Manager of Japan Division, DHL

レセプションホール RECEPTION HALL A

**FIW-C** 14:00-16:00  
生成AIがもたらす製造現場の変革  
Generative AI Will Transform the Manufacturing Workplace

日本マイクロソフト(株) 業務開発 実行役員 エンバロジスト 西脇 真智

レセプションホール RECEPTION HALL B

**PWB-5** 10:00-11:30  
パワーデバイスの活用に向けたパッケージング技術と部品内蔵基板技術  
Semiconductor Packaging and Embedding PCB Technology to Utilize Power Devices

古河電気工業(株) AT-機能開発事業部門 高級機能開発プロジェクトチーム 新製品企画 課長 石原 邦彦  
Schweitzer Electronic AG, Chief Technology Officer, Thomas Gottwald

**ISP-6** 12:30-14:00  
次世代パワーデバイスと先端パワエレモジュールの世界  
World of Next-Generation Power Devices and Advanced Power Electronics Modules

(株)ヘルクスیتالテクノロジー 第一研究開発 取締役 CTO 佐々木 公平  
Fraunhofer IZM, Group Manager Embedding & Substrate Technologies, Lars Böttcher

**FIW-S7** 15:00-15:40  
5Gによる工場のDX化推進  
Promotion of Factory DX Using 5G

(株)NTT-E Chief Standardization Officer 中村 真哉

### 東3ホール

#### 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~

Exhibitors' Product/Technology Seminar - New Tech Trend -

受講無料 FREE

1/22 (水)	15:00	SMT部品の取替用テープ除去機、 コーディング機能の紹介 SMT tape removal machine for SMT, Japan, Doping Service	E16-42 (JAPANESE)
1/22 (水)	11:00 11:30	ワイドギャップ半導体のPECVD 最新ソリューション Wide-gap semiconductor for Wide-Bandgap Power Device/ PECVD Solution	E15-24 (ENGLISH)
1/22 (水)	12:00	高出力半導体向け CVDダイヤモンドヒートスプレッダー CVD diamond heat spreader for high-power semiconductor	E19-18 (JAPANESE/ENGLISH)
1/23 (木)	13:00	SDGsに關係する ディスペンサ技術と液体材料について Dispensing technology and liquid materials for SDGs	E13-2 (JAPANESE)
1/23 (木)	14:00	洗浄プロセスで自由度が高い PFASフリー半導体用樹脂フィルム Release film for semiconductor by PFAS, Less cleaning	E21-39 (JAPANESE)
1/23 (木)	14:30	NPI 試作製造専用サービスと 14.0に沿った最新専用サービスの紹介 New Product Introduction & 14.0 Concept of Manufacturing	E24-64 (JAPANESE/ENGLISH)
1/23 (木)	13:00 13:30	次世代半導体パッケージにおける 金属錐体インクの使用 Utilization of MCP Ink in Next-Gen Semiconductor Packaging	E4-27 (JAPANESE)
1/24 (金)	14:00 14:30	機器のノイズ設計/熱設計は、 PCBの電流分布(AC/DC)把握から Noise/thermal design starts with PCB current distribution analysis	E10-42 (JAPANESE)

### 東4ホール

#### 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~

Exhibitors' Product/Technology Seminar - New Tech Trend -

受講無料 FREE

1/22 (水)	13:00	PFAS規制を見据えた R744エレクトロ用フレキブルパネルホースの開発 Development of Flexible Metal Hoses for R744 use	E35-40 (JAPANESE)
1/22 (水)	11:00 11:30	ハイテン材とアルミダイカストへの ブラスマ接合 Plasma joining for aluminum casting & high-tenal steel cast	E3-28 (JAPANESE)
1/22 (水)	12:30	UNECE R10.07 (最新版) 解説セミナー Seminar on UNECE R10.07 SUV treatment system	E40-42 (JAPANESE)
1/23 (木)	13:00 13:30	AIと自動化の最新法機動 (AI)規制法・自動運転・自動充電 Artificially driving and charging	E40-42 (JAPANESE)
1/23 (木)	14:00	SiCパワーモジュールの高温動作を支える TLP接合材料 TLP ensures high-temperature operation of SiC	E45-32 (JAPANESE)
1/23 (木)	15:00 15:30	ボルトワナへの商用車向け バッテリーシステム Regenerative battery system for commercial vehicles	E43-46 (JAPANESE)
1/23 (木)	11:00 11:30	IPX7 および自動化向け クラス最高のフライングリベット ナット Best-in-class rivet nut for IPX7 and Automation	E38-8 (JAPANESE)
1/23 (木)	12:30	PFASフリーに向けた 住金工業グループの取組み DMC Group's Initiative to Move Towards PFAS-Free Society	E45-32 (JAPANESE)
1/24 (金)	13:00	EMC設計の フロントローディングと免疫性解析 Frontloading of EMC design and Immunity Analysis Method	E47-22 (JAPANESE)
1/24 (金)	14:00	GenAI in Automotive Innovation: 変革の影りと未来への選路 GenAI in Automotive Innovation: Leading Innovation Insights	E57-8 (JAPANESE/ENGLISH)

### 東5ホール

#### モデルベース開発フォーラム Model-based Development Forum

受講無料 申込不要 FREE

1/22 (水)	11:30	MBC/IDCAE連携した システムエンジニアリングによる車載開発 Model-based Development for Vehicle Development	1/23 (木)	11:30	一層進むSiC/MBC- システムエンジニアリングによる車載開発 Model-based Development for Vehicle Development
1/22 (水)	12:00	JANES: MBC 車載開発連携推進委員会 第1回 第2回システムエンジニアリングに関する 13:00 13:30	1/23 (木)	12:00	車載システムエンジニアリングに関する 13:00 13:30
1/22 (水)	14:30	最新ソフトウェアの最新開発手法をまとめたCodeBazaar 最新ソフトウェアの最新開発手法をまとめたCodeBazaar	1/23 (木)	14:00	MBC/IDCAEによる車載開発連携推進委員会第2回 14:30
1/22 (水)	15:00	15:30	1/23 (木)	15:00	15:30

### 東6ホール

#### 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~

Exhibitors' Product/Technology Seminar - New Tech Trend -

受講無料 FREE

1/22 (水)	13:00	最新車載システム開発技術セミナー Latest technologies revolutionizing Automotive Industry	1/23 (木)	11:30	10x Expansion in Robotist & Consumer Car by End-to-End Model
1/22 (水)	13:30	車載用バッテリー管理システム EV/BEV/HEV/FCV向け	1/23 (木)	12:00	セルトランジスタ: AIx次世代半導体の発展
1/22 (水)	14:00	顧客志向 ST の次世代車向けバッテリー管理システム ST Next-Generation Automotive Battery Management Products	1/23 (木)	12:30	ソフトウェア定義車載制御: 潤滑、潤滑、および ソフトウェア定義車載制御: 潤滑、潤滑、および
1/22 (水)	14:30	顧客志向 ST の次世代車向けバッテリー管理システム ST Next-Generation Automotive Battery Management Products	1/23 (木)	13:00	ソフトウェア定義車載制御: 潤滑、潤滑、および
1/22 (水)	15:00	顧客志向 ST の次世代車向けバッテリー管理システム ST Next-Generation Automotive Battery Management Products	1/23 (木)	13:30	ソフトウェア定義車載制御: 潤滑、潤滑、および

### 東6ホール

#### 車載半導体フォーラム In-vehicle Semiconductor Forum

受講無料 申込不要 FREE

1/22 (水)	13:00	SDV時代に向けた車載SOCの取組み ユビキタス エレクトロニクス(株) ハイパフォーマンスコンピューティング プロダクトグループ HPC SOC事業部 シニアインフラストラクチャー 部長 田中 隆典	AUTO-F12
1/22 (水)	14:00	ポッシュのSiCパワーモジュールと パワーモジュールについて SiC Power Semiconductors and Power Modules from Bosch	AUTO-F1 (AI/ENGLISH)
1/22 (水)	14:30	車載向け半導体への 包括的な取組みのご紹介 Automotive Semiconductor Business Unit Senior Vice President	AUTO-F2
1/22 (水)	15:00	オンセムの 車載向けパワーソリューション Automotive Power Solutions	AUTO-F8
1/22 (水)	11:00	オンセムの 車載向けパワーソリューション Automotive Power Solutions	AUTO-F8
1/22 (水)	13:00	オートモーティブイノベーション推進 AIおよびアダプティブ、エンベデッドコンピューティングが ADAS/HVXにもたらす影響 Automotive Innovation: AI and Adaptive, Embedded Computing Impact on ADAS/HVX	AUTO-F9
1/24 (金)	14:00	拡大成長期のSiCパワー半導体市場に求められるもの ～デバイス構造による電気特性差の捉え方～ SiC Power Semiconductor Market Growth: Key Device Structure Factors for Electrical Characteristics	AUTO-F10
1/24 (金)	15:00	ソフトウェア定義の自動車 (SDV) が及ぼす 半導体部品のパラダイムシフト Software-Defined Vehicle (SDV) Impact on Semiconductor Components Paradigm Shift	AUTO-F11

### 東6ホール

#### サイバーセキュリティフォーラム Cybersecurity Forum

受講無料 申込不要 FREE

1/23 (木)	11:00	クルマを取り巻くサイバーセキュリティと Japan Automotive ISAC活動の紹介 Automotive Cybersecurity and Japan Automotive ISAC Activities	AUTO-F3
1/23 (木)	12:00	クルマのサプライチェーンにおける サイバーセキュリティの取組み Automotive Supply Chain Cybersecurity Initiatives	AUTO-F4
1/23 (木)	13:00	脅威の脅威分析結果は常に最新ですか? ～本格化するSIRT活動に備えて～ Are Threat Analysis Results Always Up-to-date? Preparing for SIRT Activities	AUTO-F5
1/23 (木)	14:00	SBOMで加速するサイバーセキュリティ Accelerating Cybersecurity with SBOM	AUTO-F6
1/23 (木)	15:00	サプライチェーンセキュリティ Supply Chain Cybersecurity	AUTO-F7

### 東7ホール

#### パワエレ アカデミックフォーラム Power Electronics Academic Forum

受講無料 申込不要 FREE

1/22 (水)	10:00	回路ロジックと その制御による受動部品の最小化 Minimization of Passive Components with Circuit Topology and Its Control	PDM-F1
1/22 (水)	12:30	パワー半導体開発の歴史と現在地 Power Semiconductor History and Current Status	PDM-F2
1/22 (水)	12:30	最新パワーモジュール技術と 高精度ゲート制御技術 State-of-the-art Power Module Technology and High-precision Gate Control Technology	PDM-F3
1/22 (水)	13:40	SiCパワー半導体デバイスの 最新技術・市場動向と熱・水・冷対策技術 Latest Technologies and Market Trends in SiC Power Semiconductor Device and Assembly Technologies	PDM-F4
1/22 (水)	12:30	GaN結晶技術が牽引する パワーデバイス GaN Crystal Technology Drives Power Devices	PDM-F5
1/22 (水)	13:40	ダイヤモンド半導体デバイスの最新進展 インフュージョンとパワー高周波デバイス Recent Development of Diamond Semiconductor Devices: Infused Water and Power RF Devices	PDM-F6

### 東7ホール

#### 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~

Exhibitors' Product/Technology Seminar - New Tech Trend -

受講無料 FREE

1/23 (木)	13:00	パワー半導体モジュール向け 高信頼性材料 High Reliability Materials for Power Semiconductor Module	E66-2 (JAPANESE)
1/23 (木)	14:00	機械学習/AI活用のための 不確かさの定量化(UQ)技術のご紹介 Machine Learning/AI Application for Uncertainty Quantification: UQ Technology Introduction	E66-27 (JAPANESE)
1/23 (木)	15:00	AIおよび自動車用途向けの 高信頼性・低遅延ハードウェアソリューション High Reliability/Low Latency Solutions for AI & Auto Applications	E66-27 (JAPANESE)
1/23 (木)	13:00	銅基板へ接合可能な 無鉛圧着高強度シナターペーストのご紹介 Lead-free pressure-resistant paste for copper substrates	E65-28 (JAPANESE)
1/23 (木)	14:00	異物対策 必須世代を乗り越える 静電電気学チカラ Foreign Matter Countermeasures Technology Electrostatic Discharge Expertise	E67-20 (JAPANESE)

### 東8ホール

#### 大学・研究機関 イノベーションフォーラム Academic Innovation Seminar

受講無料 申込不要 FREE

1/22 (水)	11:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介	1/23 (木)	11:00	ウェアラブルセンシングを活用した新たなスポーツ観戦 ウェアラブルセンシングを活用した新たなスポーツ観戦
1/22 (水)	12:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介	1/23 (木)	12:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介
1/22 (水)	13:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介	1/23 (木)	13:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介
1/22 (水)	14:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介	1/23 (木)	14:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介
1/22 (水)	15:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介	1/23 (木)	15:00	ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介 ウェアラブルデバイスと生活環境の紹介

< 注意事項 >  
 ※ 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。  
 ※ 一部の講演は、テキスト(講演資料)の配付はございません。  
 ※ セミナーの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

< Caution >  
 \* Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.  
 \* Recording and photography are strictly prohibited.  
 \* Speakers and programs are subject to change.  
 \* Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

次のページは、南展棟の  
セミナー・フォーラム一覧  
Scroll down for the overview of  
seminars / forums in South Hall.



### 南ホール2階

**カーボンニュートラル  
実践フォーラムプログラム**  
Green Factory Forum
受講無料  
FREE

日時	タイトル・出席社名	小冊子番号
13:00	<b>未利用排熱の有効活用を可能にする 熱音響冷却システム</b>	<b>S19-14</b>
	Thermoacoustic cooling system that utilizes unused heat <small>中央精機 (株) CENTRAL MOTOR WEEL CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
14:00	<b>カーボンニュートラルを実現する 遮熱塗装の効果と実例</b>	<b>S19-7</b>
	Effects and Ex of Heat-insulation paint that achieves CN <small>(株) 楽塗 RAKUTO CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
15:00	<b>製造加熱プロセスにおける潜在的な 削減可能熱量の見える化</b>	
	Visualization of potentially reduce amount of thermal energy in production heating processes <small>製造加熱プロセス デジタルツインコンソーシアム Consortium for Digital Transformation of Manufacturing Heating Processes</small>	<small>(日本産)</small>

### 南ホール2階

**新製品・新技術セミナー  
~New Tech Trend~ ① プログラム**  
Exhibitors' Product/Technology Seminar -New Tech Trend- ①
受講無料  
FREE

日時	タイトル・出席社名	小冊子番号
11:00	<b>製造現場を革新「モデル予測制御」による 省エネ・省人化</b>	<b>S27-13</b>
	Energy and Labor Savings with Model Predictive Control <small>(株) Proxima Technology Proxima Technology INC.</small>	<small>(日本産)</small>
13:00	<b>スマートファクトリー実現のための 設計開発&amp;生産現場改革</b>	<b>S27-26</b>
	Design and Production Site Reform for Smart Factory <small>NECネクサソリューションズ(株) NEC Nexsolutions, LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
14:00	<b>デジタル変革の力 データ活用が導く製造現場自動化と新たな価値</b>	<b>S21-8</b>
	AI×MI で革新! 配合レシビシミュレーションの効果 <small>NECネクサソリューションズ(株) NEC Nexsolutions, LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
11:00	<b>MP-Connect: 効率と品質を両立するMESソリューション</b>	<b>S33-32</b>
	MP-Connect's solution that combine efficiency and quality <small>MP-Connectソリューションズ(株) MP-Connect Solutions, Inc.</small>	<small>(日本産)</small>
12:00	<b>先端技術導入による ビジネスアウトプットの拡大</b>	<b>S30-14</b>
	Increasing manufacturing output by advanced technology <small>アプライド マテリアルズ システム(株) Applied Materials INC.</small>	<small>(日本産)</small>
13:00	<b>生産計画と工程設計で現場を革新! リードタイムは適切ですか?</b>	<b>S33-13</b>
	Transform site with planning is your lead time appropriate? <small>ビックフォーク(株) Bickfoork CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
14:00	<b>物流データを力に変える ~Conataが切近く物流現場のスマート化~</b>	<b>S20-33</b>
	Tuning logistic data into power ~Conata case study~ <small>(株) フライワイール FLYWIIR, INC.</small>	<small>(日本産)</small>
15:00	<b>製造現場におけるSRF無線プラットフォームの 段階的導入</b>	<b>S32-16</b>
	Step-by-Step Deployment of SRF Wireless Platform in Factory <small>フレキシブルファクトリーパートナーアライアンス Flexible Factory Partner Alliance</small>	<small>(日本産)</small>

### 南ホール2階

**新製品・新技術セミナー  
~New Tech Trend~ ② プログラム**  
Exhibitors' Product/Technology Seminar -New Tech Trend- ②
受講無料  
FREE

日時	タイトル・出席社名	小冊子番号
14:00	<b>製造・物流作業の自動化推進! ブリヂストンのソフトロボティクス</b>	<b>S1-8</b>
	Promote automation by Bridgestone softrobotics <small>(株)ブリヂストン Bridgestone Soft Robotics</small>	<small>(日本産)</small>
15:00	<b>物流ITベンダーだから実現できる ロボット導入の手引き</b>	<b>S14-34</b>
	Robot introduction guide <small>(株)セイノー情報サービス Seno Information Service CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
13:00	<b>トラック場・ハコベルDXシステムの 事例・機能紹介</b>	<b>S15-34</b>
	事例・機能紹介 <small>ハコベル(株) HAKOBELL INC.</small>	<small>(日本産)</small>
14:00	<b>物流改善アンケートから読み解く 2025年にすべき具体的施策</b>	<b>S14-34</b>
	Specific logistics improvement measures to be taken in 2025 <small>(株)セイノー情報サービス Seno Information Service CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
13:00	<b>初めてでも簡単に使える ファナックの協働ロボットによる自動化</b>	<b>S3-8</b>
	Automation with FANUC easy-for-use collaborative robots <small>ファナック(株) FANUC CORPORATION</small>	<small>(日本産)</small>
14:00	<b>物流ITベンダーだから実現できる ロボット導入の手引き</b>	<b>S14-34</b>
	Robot introduction guide <small>(株)セイノー情報サービス Seno Information Service CO., LTD.</small>	<small>(日本産)</small>
15:00	<b>WES No.1ベンダーが解説! 最適な倉庫システム選びのポイント</b>	<b>S13-1</b>
	Top WES Vendor Explains Key Points for Choosing Systems <small>(株)YEデジタル YE DIGITAL CORP.</small>	<small>(日本産)</small>

### < 注意事項 >

- ※敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- ※一部の講演は、テキスト(講演資料)の配付はございません。
- ※セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

### < Caution >

- \* Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- \* Recording and photography are strictly prohibited.
- \* Speakers and programs are subject to change.
- \* Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.